

各 位

上場会社名 株式会社かわでん
代表者 代表取締役社長 小川 善之
(コード番号 6648)
問合せ先責任者 取締役経営管理本部長 神保 能郎
(TEL 03-6433-0135)

業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、2025年5月9日に公表いたしました業績予想を下記の通り修正いたしましたので、お知らせいたします。

あわせて、本日開催の取締役会において、2026年3月期の第2四半期配当及び期末配当予想の修正を下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

2026年3月期第2四半期(累計)個別業績予想数値の修正(2025年4月1日～2025年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	中間純利益	1株当たり 中間純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	12,750	1,300	1,295	840	262.24
今回修正予想(B)	13,400	2,000	2,000	1,300	405.86
増減額(B-A)	650	700	705	460	
増減率(%)	5.1	53.8	54.4	54.8	
(ご参考)前期第2四半期実績 (2025年3月期第2四半期)	10,492	714	724	467	146.09

2026年3月期通期個別業績予想数値の修正(2025年4月1日～2026年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	25,500	2,600	2,590	1,680	524.49
今回修正予想(B)	26,800	4,000	4,000	2,600	811.71
増減額(B-A)	1,200	1,400	1,410	920	
増減率(%)	5.1	53.8	54.4	54.8	
(ご参考)前期実績 (2025年3月期)	24,218	2,589	2,664	1,963	612.88

修正の理由

国内の経済状況において、民間設備投資が増加傾向で推移しております。これにより特に半導体関連を含む大型工場や首都圏を中心とした市街地再開発事業などの建設需要は堅調に推移していくことが見込まれ、売上高につきましては当初予想を上回る見込みとなりました。

利益面におきましては採算性の高い大型案件の売上増加に加え、人件費や物流コスト上昇・部品仕入価格の高騰が継続する中での価格の調整が利益に寄与し、第2四半期の業績予想を上回る見込みとなりました。

第3四半期以降も、当第2四半期と同様に順調に推移していくことが見込まれることから2026年3月期通期業績の各利益について上記のとおり業績予想を修正いたします。

● 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (2025年5月9日発表)	—	95.00	—	95.00	190.00
今回修正予想	—	145.00	—	145.00	290.00
当期実績	—	—	—		
前期実績 (2025年3月期)	—	40.00	—	150.00	190.00

※ 2026年3月期における第2四半期末配当及び期末配当には、それぞれ創業100周年記念配当が10円含まれております。

修正の理由

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のための内部留保を考慮し、かつ安定的な配当を行うことを目標としたうえで、利益に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。
2025年度を初年度とする中期経営計画において、配当性向35%以上を目指すことから、業績予想の上方修正を踏まえ、株主の皆様のご支援に報いるため、2026年3月期の第2四半期配当及び期末配当予想を上記のとおり変更することといたしました。

以 上